

2026年6月8日(月)

TOPPAN 株式会社がマレーシアの Spring Semiconductor と販売パートナー契約を締結 — TOPPAN テクニカル・デザインセンター株式会社は当該契約に基づきマレーシアをはじめとした APAC 地域における拡販体制を強化

---

**TOPPAN**

TOPPANテクニカル・デザインセンター株式会社

**SPRING**

**SEMI**

TOPPAN テクニカル・デザインセンター株式会社（以下、TDC）の親会社である TOPPAN 株式会社は、マレーシアをはじめとした APAC 地域における IC 設計サービス、MPW<sup>1</sup>、および ASIC<sup>2</sup>ターンキー<sup>3</sup>サービスの販売パートナーとして、現地の半導体設計・プロトタイプングソリューションのリーディングプロバイダーである Spring Semiconductor Sdn. Bhd.（以下、Spring Semiconductor）と契約を結びました。

今回の戦略的パートナーシップにより、TDC は当該地域におけるサービスの提供体制を強化します。

近年、マレーシア、特に「東洋のシリコンバレー」と称されるペナン州を中心に、半導体産業の集積が加速しており、東南アジアにおける半導体製造・設計のハブとしてその重要性が高まっています。

世界有数の半導体クラスターを形成するマレーシアにおいて、現地の商習慣や技術ニーズに精通した Spring Semiconductor をパートナーに迎えることで、TDC が長年培ってきた日本品質の設計技術とグローバルな製造ネットワークを、現地市場の要求に即して提供する体制を構築しました。

特に、リソースの限られた現地のデザインハウスやスタートアップ企業、先端研究を行う学術機関にとっては、TDC の専門的な知見と製造ネットワークを直接活用できるメリットは大きく、両社の強みを融合させることで、試作段階から量産化に至るまでの技術的障壁を取り除き、マレーシアを拠点とした次世代半導体エコシステムの活性化と、地域全体の産業競争力の向上に深く寄与していきます。

本合意に基づき、Spring Semiconductor は以下の役割を担います。

- マレーシア、APAC におけるサービス拡販: TDC が提供する設計支援、MPW、ターンキーソリューションなどの拡販
- ローカルサポートの提供: 技術導入を加速させるための現地でのサポート、トレーニング、および顧客エンゲージメントの実施
- マレーシア業界アウトリーチ: 地域的な半導体設計・製造におけるマレーシアの役割を向上させるため、業界への働きかけを推進

Spring Semiconductor Sdn. Bhd. の CEO、Ken Khoo 氏は次のように述べています。「TDC とパートナーシップを組めることを光栄に思います。この連携により、世界トップクラスの能力をマレーシアの急成長する半導体分野に導入し、イノベーションへの障壁を下げ、設計者と製造者が共に発展できる豊かなエコシステムを育成してまいります」

TOPPAN テクニカル・デザインセンター株式会社の代表取締役社長、小鹿和繁は次のように述べています。「TDC は、東南アジア地域における半導体イノベーションの実現に尽力しています。マレーシアのテクノロジーリーダーとして高い信頼を得ている Spring Semiconductor との提携は、高品質な半導体設計および製造管理サービスを提供するという当社のミッションに合致するものです。本提携を通じて、東南アジア地域における半導体エコシステムの発展に貢献していきたいと考えています。」

TDC および Spring Semiconductor は設計・製造の強固な架け橋として、マレーシアの半導体エコシステムのさらなる高度化を支援し、アジアから世界へ発信される次世代の技術革新を強力にバックアップしていきます。

## Spring Semiconductor について

Spring Semiconductor は、企業、スタートアップ、およびアカデミア向けに半導体の設計とプロトタイピングを支援するテクノロジー企業です。設計サービス、トレーニング、エコシステム開発を通じて、革新的なアイデアをより速く、よりスマートに、そしてより費用対効果の高い方法でシリコン化（製品化）することを目指しています。

URL: <https://springsem.com/>

## TOPPAN テクニカル・デザインセンター株式会社について

TOPPAN テクニカル・デザインセンター株式会社は、半導体サービスのグローバルリーダーであり、世界中の顧客に設計支援、ターンキー、MPW アクセス、および先端パッケージングソリューションを提供しています。設計と製造の架け橋となる専門知識を活かし、コンセプト段階から量産まで、顧客のビジネススケールアップを支援しています。

URL: <https://www.toptdc.toppan.com/>

---

本件に関するお問い合わせ先：

TOPPAN テクニカル・デザインセンター株式会社

事業管理部 事業戦略 T

東京都港区芝浦 3-19-26

URL: <https://www.toptdc.toppan.com/>

Email: [yoshiyuki\\_2.takahashi@toppan.co.jp](mailto:yoshiyuki_2.takahashi@toppan.co.jp)

TEL: 070-3220-6976

---

<sup>1</sup> MPW (Multi-Project Wafer) : 1 枚のシリコンウェハー上に複数の異なる設計（プロジェクト）を相乗りさせて製造する方式。試作コストを大幅に抑えることが可能。

<sup>2</sup> ASIC (Application Specific Integrated Circuit) : 特定の用途のために設計・製造される専用の集積回路。汎用 IC と比較して高性能・低消費電力が期待できる。

<sup>3</sup> ターンキー：設計から製造、テスト、納品までの一連の工程を、一括して請け負うサービス形態。